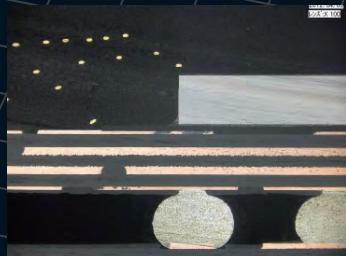


超音波カッティング装置

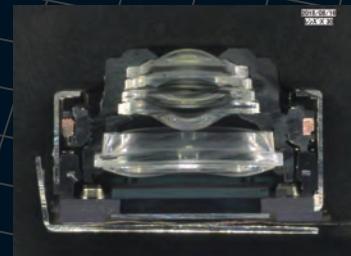
ULTRASONIC Cutting System CSX-100Lab

断面観察用試料作製に特化した自動切斷装置

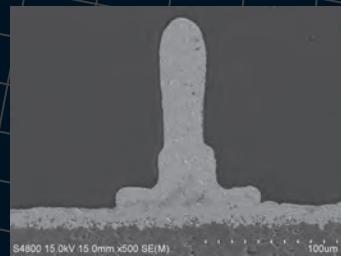
- ◆超音波アシスト切斷により、「切る」+「磨く」を同時にを行い、断面観察までの作業効率を大幅に改善 !!



バンプ断面



携帯電話内蔵カメラ



ワイヤー断面

ULTRASONIC Cutting System CSX-100 Lab

用 途

◆ 開発品や製品の断面観察試料作製時間を短縮して業務の効率化を実現！

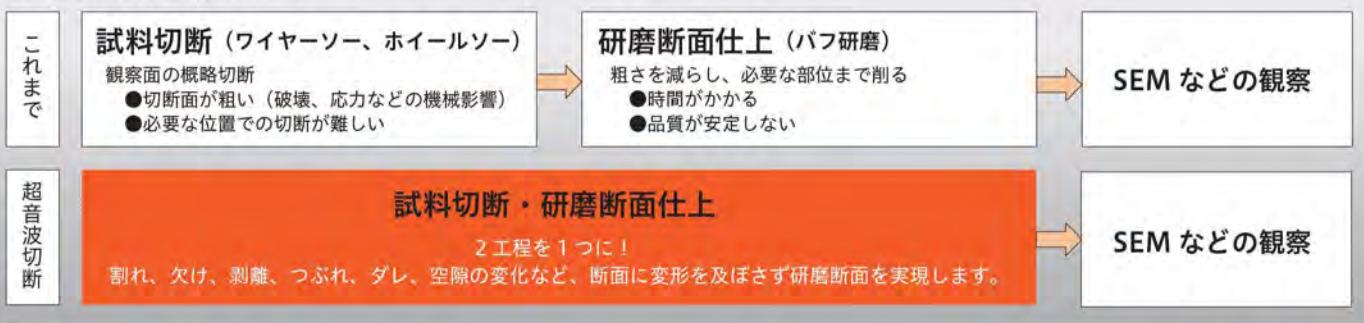
特 長

- ◆ 硬脆材や複合材などの難切材を一度に切断
- ◆ PolishCut™（ポリッシュカット）により切断断面を研磨
- ◆ 超音波振動の作用によりブレード目詰まりを抑制し、ブレード摩耗を低減
- ◆ 刃先出し 10mmで、部品実装された基板でもそのまま切断可能
- ◆ 観察箇所をモニターで見てセットするため、観たい箇所をダイレクトに切断可能
- ◆ 試料を装置内にセットした後は自動切斷
- ◆ 切断により試料を切り分けるため、分割した試料それぞれを観察することが可能
- ◆ スケルトンカット（オプション）を合わせて導入することで、モールドされた電子部品の内部を狙って切斷可能
- ◆ イオンミリングなどの前処理装置（ミリング時間の短縮）として導入実績が多数



CSX-100 操作画面

[断面観察試料製作フロー]



断面品質をご確認いただくため、無償サンプルカット受け付けております。

お気軽にお問い合わせ下さい！！

装 置 仕 様

型 式	CSX-100 Lab
切斷可能最大ワークサイズ	100Φ (75角)
切斷可能最大ワーク高さ	9 mm
操作／表示部	タッチパネル
オプション	切削水循環ユニット、スケルトンカット、ズームレンズ、各種治具
ユーティリティー	3相 200V 30A、切削水（市水）、圧空、廃液、排気、冷却水
寸 法	650 ^(W) × 905 ^(D) × 1,350 ^(H) mm
重 量	350kg



株式会社 高田工業所 装置事業部

〒806-8567 福岡県北九州市八幡西区築地町2-1

TEL(093)632-2600 FAX(093)632-2625

<https://www.takada.co.jp/jigyo/usw/>

■仕様は予告なく変更することがあります。

■本シートを無断で複製することを禁じます。 US-LF-CSX100-006 29-Nov./2018

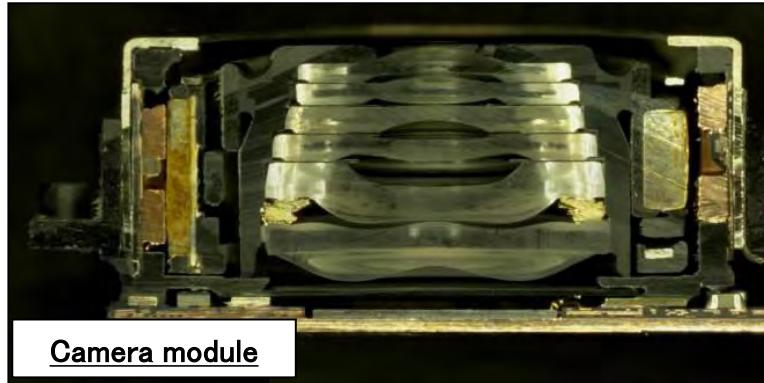
TAKADA
The New Solution Provider

Cutting sample

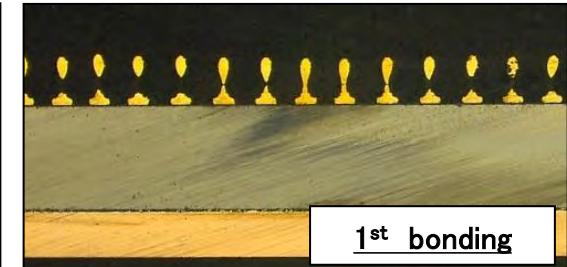
(研磨なし) As cut (Without polishing)



Mounting board

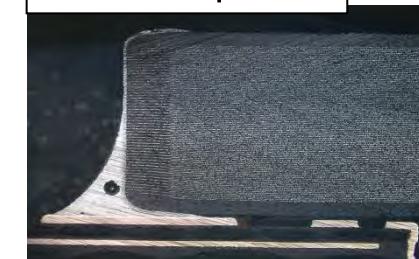


Camera module

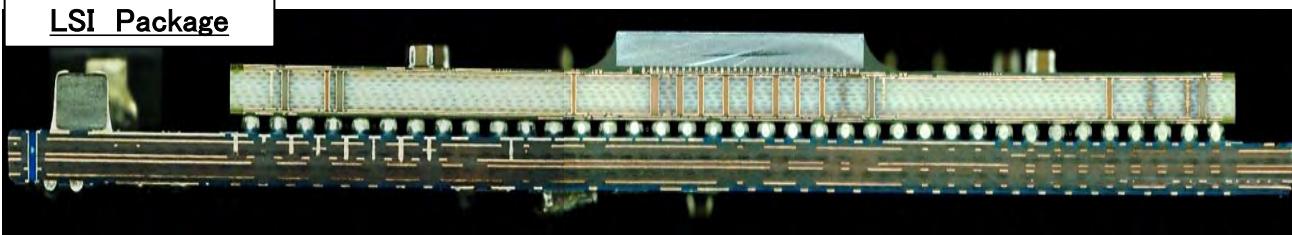


1st bonding

Ceramic capacitor



LSI Package



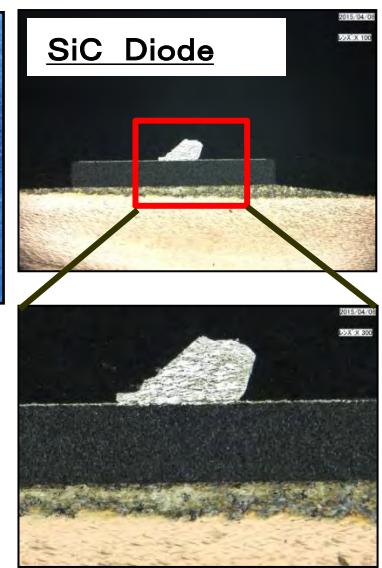
Memory card



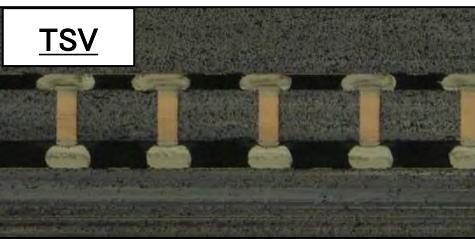
FPC



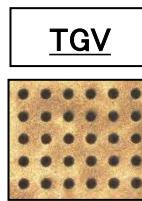
SiC Diode



PCB



TSV



TGV

